**北京市第二十届印刷行业职业技能大赛**

**印品整饰复赛复习题**

1. **单选题（80题）**

1．覆膜时，黏合剂和被黏合物界面消失，借助化学键形成牢固的黏合，表现为（ C ）。

A.吸附作用 B.静电作用

C.扩散作用 D.毛细作用

2．覆膜的作用是（ A ）。

A.保护印刷品表面 B.增加印刷品颜色饱和度

C.防伪 D.使用方便

3.覆膜的作用是（ A ）。

A.保护印刷品表面 B.便于收藏

C.防伪 D.使用方便

4.覆膜用塑料薄膜常用的表面处理方法有（ A ）。

A,电晕处理 B.表面清洗 C.去除静电 D.软化处理

5.BOPP薄膜的优点不包括（ D ）。

A.机械强度高 B.气密性好

C.防潮阻隔性好 D.易伸长

6.如印后油墨未干就进行干式覆膜易产生（ A ）故障。

A.起泡 B.起皱 C.卷曲 D.出膜

7.需覆膜的印刷品墨层过厚可釆取（ A ）的对应措施。

A.加大覆膜压力 B.降低覆膜温度

C.减少黏合剂用量 D.提高机速

8.覆膜用的PE是（ C ）薄膜。

A.硝酸纤维 B.醋酸纤维 C.聚乙烯 D.聚酯

9.覆膜的工艺参数不包括（ B ）。

A.温度 B.湿度 C.压力 D.速度

10.覆膜用的PP是（ C ）。

A.双向拉伸聚丙烯 B.双向拉伸聚乙烯

C.聚丙烯 D.聚酯

11.上光与覆膜比较，（ A ）比较接近。

A.光亮程度 B.工艺性 C.坚固程度 D.耐磨性

12.上光的作用是（ B ）。

A.保护印刷品表面 B.增加印刷品表面光泽度

C.防伪 D.使用方便

13.在UV上光油中，（ C ）含量虽少，但对上光油的固化性能却起决定性作用。

A,感光树脂 B.活性稀释剂

C.光引发剂 D.助剂

14.为改善上光油主剂树脂的成膜性，增加膜层内聚强度而加入的助剂是（ B ）。

A.表面活性剂 B.固化剂

C.消泡剂 D.增塑剂

15.UV上光油的优点不包括（ C ）。

A.上光质量好 B.固化速度快

C.产生臭氧 D.污染小

16.质量优良的水性上光油应该是（ B ）的产品。

A.低黏度低固含量 B.低黏度高固含量

C.高黏度低固含量 D.高黏度高固含量

17.上光干燥方法中不包括（ D ）。

A.热风干燥 B.红外线干燥

C.紫外线干燥 D.燃气干燥

18.水性上光过程气泡多的原因不包括（ A ）。

A.温度偏高 B.上光油pH值偏低

C.循环搅拌过度 D.上光油黏度偏高

19.电化铝箔的铝层釆用（ A ）。

A.真空镀铝 B.压延薄铝片

C.铝粉 D.薄片与黏合剂

20.（ C ）不是电化铝箔的组成部分。

A.隔离层 B.颜色层

C.铝板层 D.胶黏层

21.电化铝箔材有（ C ）层。

A.三 B.四

C,五 D.六

22.解决烫印中的反拉可采用（ C ）。

A.高强度铝箔 B.高压

C.使油墨干燥 D.高温

23.电化铝烫印工艺中，镀铝层是靠（ A ）附着在承印物上。

A.黏合剂 B.铝层与承印物吸附力

C.在温度和压力作用下铝层熔化 D.静电力和扩散力

24.造成烫印反拉的原因是（ D ）。

A.烫印温度低 B.烫印压力小

C.烫印速度慢 D.印刷品表面油墨未干

25.烫印工艺的压力（ B ）。

A.比胶印压力小 B.比胶印压力大

C.与胶印压力相同 D.无压力

26.电化铝箔的染色层除具有表现颜色外，还具有（ A ）功能。

A.防氧化 B.易与片基层剥离

C.增加结合力 D.具有高反射率

27.电化铝箔依靠（ C ）附着在印刷品表面。

A.温度 B.压力

C.黏合剂 D.速度

28.烫印温度过低，会出现（ A ）。

A.烫印不上 B.花白

C.变成红蓝色 D.光亮度降低

29.冷烫印不需要（ C ）。

A.压力 B.黏合剂

C.温度 D.承印物

30.导致图文印迹不齐整有毛边的原因主要有三个，以下哪一个不是？（ C ）

A.烫印版压力过大 B,压印机构垫贴不合适

C.烫印速度过慢 D.烫印温度过高

31.全息标识烫印技术是一新型激光（ C ）技术，是将激光全息图像烫印在承印物上的技术。

A.印刷 B.压凹凸 C.防伪 D.模切

32.大面积烫印时，（ A ）应有较大的提高才行，因此烫印箔的质量受其影响很明显。

A.温度 B.速度 C.压力 D.机器

33.（ A ）是利用热压转移原理，将铝层转印到承印物表面。

A.普通烫印 B.上光 C.覆膜 D.压凹凸

34.通常电化铝箔的组成结构由里向外是（ B ）。

A.片基层一染色层一隔离层一镀铝层-胶黏层

B.片基层一隔离层-染色层一镀铝层一胶黏层

C.片基层一隔离层-镀铝层-染色层-胶黏层

D.片基层-镀铝层一染色层一隔离层-胶黏层

35.印刷品的深色墨层比淡色墨层（ C ）烫印。

A.容易 B.很难 C.较难 D.较容易

36.避免烫印不上或烫印不牢故障发生的措施是（ C ）。

A.降低温度 B.降低压力 C.提高温度 D.提高速度

37.由于立体烫印印版上图文与空白部分的高低较为明显，烫印时需要的压力比平面烫金时的压力（ A ），因此需要调整好烫印压力，以免出现剪切力不足或印迹变粗的现象。

A.大 B.小 C.差不多 D.相同

38.冷烫印工艺通常釆用（ B ）加工形式。

A.平压平 B.圆压圆 C.圆压平 D.平压圆

39.从烫印效果来看，以（ C ）是较理想的。

A,较小压力，较低温度和略快速度

B.适当压力，较低温度和略快速度

C.适当压力，较低温度和略慢速度

D.较小压力，较低温度和略慢速度

40.在烫印压力较小，速度快，底色墨层较厚的情况下，烫印温度可（ C ）。

A.较大提高 B.不做调整

C.适当提高 D.适当降低

41.整体式模切版一般用在（ A ）模切机上。

A.圆压圆 B.圆压平

C.立式平压 D.卧式平压平

42.模切、压痕版中，橡皮条粘在（ A ）。

A.模切刀两侧 B.压痕线两侧

C.模切刀刃口处 D.压痕线刃口处

43.模切、压痕版中，打点在（ C ）。

A.模切刀两侧 B,压痕线两侧

C.模切刀刃口处 D.压痕线刃口处

44.模切、压痕所用钢刀和钢线高度（ B ）。

A.两者等高 B.钢刀高

C.钢线高 D.不确定

45.模切垫版的作用是（ B ）。

A.调节模切版左右位置 B.调节模切压力

C.调整模切版上下位置 D.调整模切版距边口位置

46.钢刀常用高度为（ D ）mm。

A.23 B.22

C.24 D.23.8

47.模切版粘橡胶条的作用是（ C ）。

A.增加模切版的弹性 B.缓冲减震

C.防止产品夹刀 D.增加压力

48.钢线的高度略低于钢刀高度，通常为（ C ）mm。

A.22〜23 B.21〜22

C.22〜23.8 D.22.5〜23

49.瓦楞纸压痕中所用的压痕模类型为（ D ）。

A.超窄型压痕模 B.单边窄型压痕模

C.连坑型压痕模 D.斜角型压痕模

50.使用胶合木板作为衬空材料时，木板厚度一般为（ D ）mm左右。

A.15 B.16

C.17 D.18

51.以下模切压痕排刀工艺中精度最高的为（ C ）。

A.手工排刀 B.机械排刀

C.激光排刀 D.组合排刀

52.模切版上粘橡胶条应高出刀口（ D ）为宜，硬橡胶条高出少一些，软橡胶可高出多一些。

A.1〜2mm B.2〜3mm

C.3〜4mm D.3〜5mm

53.模切PVC塑料片宜选用（ A ）钢刀。

A.硬性 B.中性

C.软性 D.弹性

54.模切、压痕模切刀口不光洁的原因不包括（ C ）。

A.钢刀质量不良 B.钢刀磨损严重

C.压力过大 D,钢刀处垫纸处理不当

55.模切、压痕后压痕线不规则的原因不包括（ D ）。

A.压痕槽太宽 B.钢线垫纸厚度不足

C.钢线松动 D.速度过大

56.模切压痕版平衡刀安装在模切压痕版（ A ）。

A.空白处 B.模切刀密集处

C.压痕线密集处 D.任意位置

57.模切压痕版平衡刀应使用（ C ）模切区域的模切刀。

A.略高于 B.略低于'

C.相同于 D.任意

58.模切压痕版平衡刀应使用（ C ）模切区域的海绵胶条。

A.硬度高于 B.硬度低于

C.相同于 D.任意

59.模切压痕机的清废功能（ D ）。

A.能清除所有废边 B.不能清除所有废边

C.不能清除叼口废边 D.机型不同，清废形式不同

60.模切瓦楞纸板时，压痕模的厚度为（ B ）厚度。

A.瓦楞纸板 B.压实后的瓦楞纸板

C.略大于瓦楞纸板 D.略小于瓦楞纸板

61.（ B ）是压凹凸最常见故障。

A.凹版损坏 B.凸版损坏

C.纸板损坏 D.压板损坏

62.压凹凸图文轮廓不清的原因是（ A ）。

A.装版时垫版不实 B.压力过大

C.温度过高 D.速度过快

63.（ C ）不是压凹凸图文轮廓不清的原因。

A.装版时垫版不实 B.压印机精度差

C.温度过高 D.凸版磨损

64.压凹凸图文套印不准的原因是（ B ）。

A.纸张受润湿液影响 B.印版版框位移

C.速度过快 D.压力过大

65.压凹凸纸张压破的原因是（ D ）。

A.时间过长 B.温度过高

C.速度过快 D.纸张质量差

66.压凹凸中，凹版的雕刻深度需根据纸张承受压力程度到不破为宜，一般深度控制在版厚的（ C ）左右。

A.10% B.20%

C.50% D.70%

67.压凹凸中，产生图文表面斑点的原因不包括（ D ）。

A.石膏粉有杂质 B.承印物表面不光洁

C,凹版表面有石膏颗粒 D.压力不均匀

68.下面哪一项不是引起压凹凸中纸张压破的原因？（ B ）。

A.纸张太薄 B.石膏太硬

C.压力不均匀 D.印版边角过渡坡度大

69.压凹凸图文轮廓不清的原因不包括（ D ）。

A.承印物厚薄不均 B.双张

C.多张 D.压力过大

70.压凹凸图文套印不准的原因不包括（ D ）。

A.印版与图文不符 B.规矩位置不准确

C.印版版框位移 D.承印物厚薄不均

71.机器糊盒不包括（ D ）。

A.糊单边 B.糊四角

C.糊双边 D.糊提手

72.糊盒时，胶水完全干燥后，撕开粘口二纸边，（ A ）为合格。

A.能将其中一面纸张撕下 B.断裂

C.不能撕断 D.用力撕断

73.预折装置是根据压痕线将纸盒弯曲（ A ）左右，再返回到原来的形状，主要是为了糊盒时减少损差

A.150° B.90°

C.60° D.30°

74.糊盒机上胶装置是通过（ D ）或喷胶装置给纸盒黏合部上胶，完成黏合。

A.刷子 B.胶盘

C.胶盒 D.胶囊

75.（ D ）不是粘盒不牢的原因。

A.黏合剂的黏度不够 B.黏合剂涂布量不足

C.黏合剂和纸盒材料不适应 D.温度过高

76.（ B ）不是糊盒歪斜的原因。

A.模切版精度不高 B.压力过大

C.纸板吸湿变形 D.粘口对位不准

77.经过上光、压光、覆膜等工艺处理后，糊盒时，粘接部位（ A ）。

A.表面张力大 B.表面张力小

C.粗糙度大 D.粗糙度小

78.造成糊盒产品爆线的原因不包括（ D ）。

A.模切单边 B.成型刀压到了痕线

C.预折器调节位置不佳 D.车间湿度太大

79.糊口部位表面处理的方法主要有（ B ）。

A.光化学技术 B.等离子技术

C.火焰处理技术 D.清洗技术

80.糊盒压力的调节主要是对（ C ）压力的调节。

A.压轮 B.导杆

C.加压皮带 D.传送带

**二、多项选择题（40题）**

1.覆膜的方法有（ ABD ）。

A.干式覆膜 B.湿式覆膜 C.无水覆膜 D.预涂覆膜

2.覆膜的工艺参数有（ ACD ）。

A.温度 B.湿度 C.压力 D.速度

3.BOPP薄膜的优点是（ ABC ）。

A.机械强度高 B.气密性好

C.防潮阻隔性好 D.易伸长

4.覆膜产品表面起泡的原因是（ABCDE）。

A.纸张含水率高 B.纸张掉粉

C.油墨过厚或不干 D.油墨中快干剂过多

E.胶层过薄或太厚

5.覆膜常用塑料薄膜包括（ABCD）。

A.聚丙烯薄膜PP B.聚氯乙烯薄膜PVC

C.聚乙烯薄膜PE D.聚酯薄膜PET

6.上光干燥主要釆用（ ABC ）等方法。

A.热风干燥 B.红外线干燥

C.紫外线干燥 D.燃气干燥

7.UV上光具有（ ABCD ）等特点。

A.高亮度 B.高耐磨性

C.不褪光 D.污染小

8.UV上光固化特点是上光油能（ ABD ）。

A.瞬时固化 B.不会粘连 C.热量散发较大 D.无溶剂挥发

9.水性上光光泽不好，亮度差的原因是（ ABCDE ）。

A.纸质太粗 B.上光油涂层太薄 C.上光油固含量不足

D.印刷品油墨未干 E.上光油质量差

10.UV上光光泽不好，亮度差的原因是（ ABCDE ）。

A.UV上光油涂层太薄 B.纸张粗糙 C.印刷品油墨未干

D.UV上光油质量差 E.光源光强度不足

11.电化铝箔表面应（ ABCD ）等。

A.无发花 B.无砂眼 C.无皱折 D.无划痕

12.电化铝箔烫印工艺参数包括（ ABC ）。

A.烫印温度 B.烫印压力 C.烫印速度 D.烫印频率

13.立体烫印需要（ ABCD ）。

A.烫印版 B.阴模 C.阳模 D.电化铝箔

14.电化铝烫印不上是由于（ ABCD ）。

A.烫印温度过低 B.烫印压力小

C.底墨干燥过度 D.喷粉太多

15.烫印温度过低，会出现（ AB ）。

A,烫印不上 B.图文发花 C.图文发虚 D.图文发晕

16.烫印的图文发虚、发晕的原因为（ AC ）。

A.烫印温度过高 B.烫印温度过低

C.电化铝箔焦化 D.烫印压力大

17.烫印温度过高，会出现（ BCD ）。

A.烫印不上 B.变成红蓝色

C.光亮度随之降低 D.图文发晕

18.烫印图文印迹不齐的原因是（ ABCD ）。

A.印版压力不匀 B.印版压力过小

C.压印机构垫贴不合适 D.烫印温度过低

19.烫印糊版的原因是（ ABCD ）。

A.烫印温度过高 B.烫印版制作不良

C.电化铝镀铝过厚 D.烫印压力过大

20.烫印后露底的原因是（ BCD ）。

A.烫印速度快 B,压力小

C.温度低 D.被烫物花纹过深

21.模切、压痕机一般釆用（ ABC ）调节模切压痕位置。

A.前规 B.套准标记

C.拉规 D.推规

22.模切、压痕版排版时，尖角线截止于另一个直线的中间段落，会使（ ABD ）。

A.固刀困难 B.钢刀易松动

C.不美观 D.降低模切适性

23.模切、压痕常见质量问题主要有（ ABCD ）等。

A.尺寸不精确 B.造型不美观

C.压痕不清晰 D.切边不光洁

E.效率不高

24.造成模切刀痕不光洁的原因主要有（ ABC ）。

A.钢刀刃口不锋利 B.压力不足

C.刀版松动 D.速度快

25.模切、压痕位置不准确的原因是（ ABCDE ）。

A.版面尺寸计算不精确

B.排刀位置与印刷品不相符

C.模切与印刷格位未对正

D.纸板叼口规矩不一

E.纸板变形

26.模切、压痕爆线产生的原因是（ ABC ）。

A.钢线垫纸过低或过高

B.压力过大或过小

C.纸张含水率低

D.温度过高

27.模切、压痕后压痕线不规则的原因是（ ABC ）。

A.压痕槽太宽

B.钢线垫纸厚度不足

C.钢线松动

D.速度过大

28.钢线形状主要有（ ABCD ）、尖头线。

A.单头线 B.双头线

C.圆头线 D.平头线

29.钢刀刃口形状主要有平直形刃口和（ ACD ）。

A,齿形刃口 B.弯形刃口

C.波浪形刃口 D.针孔形刃口

30.纸盒折叠成型时，折痕处开裂的原因是（ ABC ）。

A.压痕过深 B.模压压力过大

C.折叠太深 D.温度过高

31.压凹凸所用印版有（ CD ）。

A.平版 B.柔性版

C.凹版 D.凸版

32.压凹凸图文轮廓不清的原因是（ ABC ）。

A.承印物厚薄不均 B.双张

C.多张 D.压力过大

33.压凹凸图文套印不准的原因是（ ABC ）。

A.印版与图文不符 B.规矩位置不准确

C.印版版框位移 D.承印物厚薄不均

34.压凹凸纸张压破的原因是（ AB ）。

A.印版边角过渡不合理 B.纸张质量差

C.温度过高 D.速度过快

35.压凹凸过程中，产生图文表面斑点的原因包括（ ABC ）。

A.石膏粉含有杂质 B.承印物表面不光洁

C.凹版表面粘上石膏颗粒 D.压力不均匀

36.包装纸盒的结构形式有（ ABCD ）等。

A.罩盒式 B.摇盖式

C.双插口式 D.封底插口式

37.机器糊盒有（ ABCD ）。

A.糊单边 B.糊四角

C.糊双边 D.糊单边兼扣底

38.糊盒黏合不牢的原因是（ ABCD ）。

A.黏合剂黏度低 B.黏合剂涂布量不足

C.黏合剂与纸盒材料不匹配 D.加压时间不足

39.造成糊盒产品爆线的原因有（ ABC ）。

A.模切单边 B.成型刀压到了痕线

C.预折器调节位置不佳 D.车间湿度太大

40.糊盒压力的调节主要是对（ AD ）压力的调节。

A.输纸皮带 B.压轮

C.导杆 D.加压皮带

三、判断题（80题）

1.印刷品墨层薄对覆膜影响较小。 （ √ ）

2.覆膜后光泽度高是因为塑料薄膜很薄。 （ √ ）

3.覆膜用薄膜进行表面处理是由于减少表面张力。 （ √ ）

4.覆膜前，BOPP薄膜表面要经过处理，表面张力应达到(3.8〜4.0)X10\_2N/m。 （ × ）5.塑料薄膜表面张力值偏大，不易被黏合剂润湿。 （ × ）

6.覆膜过程中的温度过低，容易使覆膜产品发翘。 （ × ）

7.覆膜后光泽度高是因为塑料薄膜很厚。 （ × ）

8.经电晕处理的薄膜有一个有效期，处理程度会随存放时间的延长而减弱。 （ √ ）

9.当印刷墨层过厚时，覆膜容易出现气泡，这时应该减少黏合剂涂布量，降低压力。 （ × ）

10.覆膜用塑料薄膜常用的表面处理方法有电晕处理。 （ √ ）

11.上光是在印刷品表面涂布一层无色透明黏合剂的工艺过程。 （ × ）

12.与红外线干燥相比，UV上光固化装置烘道较长。 （ × ）

13.纸张平滑度高吸收性小的印刷品，上光涂布液黏度可以稍高一些。 （ × ）

14.印刷品表面平滑度低容易造成上光后的印品光泽度不够。 （ √ ）

15.上光涂布的涂布量越大，涂料越能形成连续完整的膜层，上光后的光泽度就越高。 （ × ）

16.烫印方式中，最常用的是电化铝烫印。 （ √ ）

17.烫印反拉现象是在烫印后电化铝箔片基上没有油墨痕迹。 （ × ）

18.电化铝箔颜色有金色、银色、白色三种。 （ × ）

19.金箔烫印是将金延展成薄的箔片，用黏合剂粘贴到印刷品表面。 （ √ ）

20.电化铝箔烫印是将铝延展成薄的箔片，用黏合剂粘贴到印刷品表面。 （ × ）

21.电化铝箔最大的缺点是容易氧化而发黑。 （ × ）

22.烫印温度升高，电化铝箔应不变色。 （ × ）

23.电化铝箔耐高温，温度过低，金属的光亮度降低。 （ × ）

24.烫印温度略高，烫印时间可短一些。 （ √ ）

25.烫印温度略低，烫印时间应略长一些。 （ √ ）

26.在已经印刷过的墨层表面烫印电化铝箔，必须待墨层干燥牢固后才能烫印。

（ √ ）

27.全息烫印是将激光全息图烫印在承印物上。 （ √ ）

28.全息定位烫印釆用相应的防伪图案，工艺复杂，难以仿制，具有安全性和防伪功能。 （ √ ）

29.立体烫印是实现烫印和压凹凸一次完成的工艺过程。 （ √ ）

30.立体烫印只能釆用平压平烫印模切机。 （ × ）

31.反拉是指烫印后电化铝箔将印刷油墨或印件上光油等拉走。 （ √ ）

32.电化铝箔的片基层，在烫印过程中不能因烫印升温而发生变形，应具有强度大、抗拉、耐高温等性能。 （ √ ）

33.印刷品的表面整饰包括上光、覆膜、金属墨印刷、烫金和凹凸压印等。 （ × ）

34.冷烫印技术的优点是烫金箔的表面强度比普通烫金箔表面强度强。 （ × ）

35.当烫印温度过低导致烫印不上或图文发花时，要适当调低电热底板的温度，直到烫印出合格产品位置。 （ × ）

36.烫印的图文发虚、发晕主要原因是烫印压力过大，或停机时间过长导致电化铝箔焦化。 （ × ）

37.试烫速度必须从慢到快，发现不正常情况要立刻停机排除故障，试烫后检查样张，如果一切正常，则可进入正常运转，进行正式烫印。 （ √ ）

38.全息烫印箔的结构与普通烫印箔相比，染色层是色料，即显示色彩或图像的不是颜料，而是激光束作用后在转印层表面微小坑纹（光栅）形成的全息图案。

（ × ）

39.烫印速度决定了电化铝箔与被烫印材料的接触时间，接触时间直接决定了烫金产品的质量。 （ × ）

40.烫印温度过低，会出现烫印不上。 （ √ ）

41.根据所模切产品材料的不同，模切刀刃口分为硬性、中硬性、软性三种。 （ × ）

42.排好模切压痕版后，在钢刀的刀口侧边粘上橡胶条，利用橡胶条的弹性作用，将模切的产品从刀口间推出。 （ √ ）

43.纸张纤维排列与模切压痕的钢刀、钢线垂直，模切时纸张就不易断裂,必须加重模切压力，压痕时线痕较理想。 （ √ ）

44.钢质压痕模是直接在底模钢板上加工成压痕模槽，具有极好的尺寸稳定性和机械强度。 （ √ ）

45.纸盒爆线是指压、折痕处出现破损的现象。 （ √ ）

46.在模切压痕过程中，钢刀与钢线距离较小时，会出现“抢纸"现象。 （ √ ）

47.模切、压痕制版中选用较硬的橡胶条可解决“抢纸”现象。 （ √ ）

48.模切压痕时，防止出现连续的多个尖角，对无功能性要求的尖角，可改成圆角。 （ √ ）

49.钢线的高度略高于钢刀的高度，被模切材料的不同厚度对钢线的厚度选择也不相同。 （ × ）

50.滚筒模切压痕刀具主要用于圆压平模切机。 （ × ）

51.连接点就是在模切刀刃口部开一定宽度的小口，确保在模切后废品边仍有局部连接在整个印张上而不会散开，以便于下一步走纸顺畅。 （ √ ）

52.压痕刀具也称钢线、压痕线与钢刀的要求相类似，钢线也要求具有良好的耐磨性、弯曲方便等特性。 （ √ ）

53.凹凸压印工艺与模切压痕工艺和烫印工艺可以在同一台机器上进行。 （ √ ）

54.凹凸压印机可以用平压平印刷机或圆压平印刷机改造而成。 （ √ ）

55.凹凸压印的各种凸状图文和花纹，显示出深浅不同的纹样，具有明显的浮雕感。

（ √ ）

56.压凹凸是用凹凸两块印版，把印刷品压印出浮雕状图像的加工。 （ √ ）

57.压凹凸工艺不用油墨，不用胶相。 （ √ ）

58.压凹凸工艺的凸版一般采用铜板或钢板做版材。 （ × ）

59.压凹凸工艺的凹版釆用石膏或高分子材料作版材。 （ × ）

60.压纹就是利用压力的作用在纸板、复合材料表面形成某种特殊的花纹。 （ √ ）

61.压凹凸工艺的凹版一般釆用铜板或钢板做版材。 （ √ ）

62.压凹凸工艺的凸版采用石膏或高分子材料作版材。 （ √ ）

63.纸盒黏合剂固化后揭开粘接部位，纸板纤维破损的面积不小于涂布黏合剂面积的50%,并且破损面分布均匀。 （ √ ）

64.模切质量与糊盒质量无关。 （ × ）

65.一般情况下，黏合剂分子量越高，黏合强度越小。 （ × ）

66.黏合剂的辅助材料如防老化剂、稳定剂抗氧化剂等可以延长黏合剂的使用寿命。

（ √ ）

67.糊盒速度越快，就需要选择开放时间和固化时间较短的胶水。 （ √ ）

68.磨边适用于经过UV上光和覆膜的纸盒。 （ √ ）

69.产品批量脱胶与胶水的固含量有一定的关系。 （ √ ）

70.表面只要是水性上光，釆用任何胶水糊盒都不会脱胶。 （ × ）

71.随着季节的变化，要求胶水供应商所提供的胶水黏度也要随季节变化。 （ √ ）

72.出料输送带的位置与走纸平稳无关。 （ × ）

73.预折角度的大小和纸盒的开合力有直接关系。 （ √ ）

74.使用两个刀门时，刀门的位置可以任意选择。 （ × ）

75.计数电眼的安装可以选择在纸盒的任何位置。 （ × ）

76.糊盒是承印物经过模切压痕后，按纸盒成型要求在需要涂布黏合剂的位置涂上胶黏剂，再折叠并压合成型的工艺过程。 （ √ ）

77.一般来说，在纸盒加工过程中，糊盒通常是最后一个环节。 （ √ ）

78.按纸盒的结构及封口形式来分，有折叠式纸盒、扣盖式纸盒、压盖式纸盒和固定纸盒等。 （ × ）

79.糊盒胶水的组成中，含有非极性基团的物质是理想的胶料。 （ × ）

80.预折装置是根据压痕线将纸盒弯曲90°左右，再返回到原来的形状，主要是为了糊盒时不会出错。 （ × ）